

UV Laser Drill System

■ UV Laser Drill System - Model 5330

- High Power Diode-pumped laser for high productivity
Repetition frequency of up to 70 kHz
- High-quality vias as small as 25 microns Higher accuracy for improved wiring density
- Beam Shaping Capability Automatic Mode Change
- High accuracy ablation of soldermask resist

ESI社のモデル5330-UVレーザ・μピア・ドリル・システムは、微細回路基板や電子部品パッケージ用途において高品質なマイクロピアを達成する為の最適なツールです。

このシステムは、HDI、ICパッケージング及び、フレキシブル基板のニーズに適合する為の様々な光学系のコンフィグレーションを選択出来る様デザインされております。

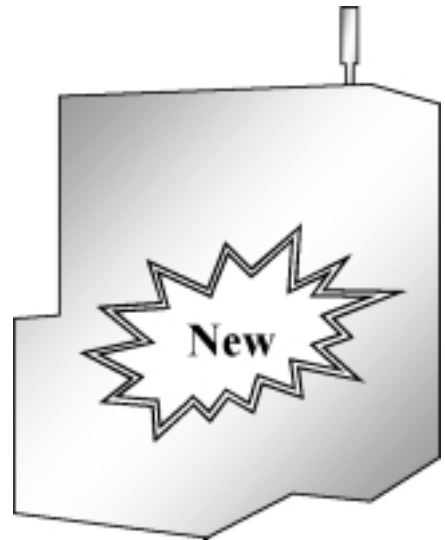
オプションのShaped Beamでは、高真円度で高い生産性を可能とするのみならず、樹脂層やソルダマスクへのダイレクト・アブレーション加工も可能とします。更に、ビア底Cu層表面の炭化物を残しにくく、高品位のビアを形成する事が可能です。



■ New Dual Head UV Laser Drill System for IC Packaging

- Specifically designed for the IC Packaging Market
- High-speed beam positioning system with GVD
- Increased optical efficiency
- Dual illumination
- Coordinated motion control

新機種であります為、詳細は弊社ブースにてご説明させていただきます。



esi

イー・エス・アイ・ジャパン株式会社
Electro Scientific Industries Japan Co., Ltd.

〒141-0022

東京都品川区東五反田1-11-15 電波ビル1F

Tel: 03-3440-5081 / Fax: 03-3440-5029

URL <http://www.esi.com/>

Email: Tajimaa@esi.com